

Title (en)  
Coil bobbin

Title (de)  
Spulenkörper

Title (fr)  
Corps de bobine

Publication  
**EP 0773564 A1 19970514 (DE)**

Application  
**EP 96117287 A 19961028**

Priority  
DE 19541447 A 19951107

Abstract (en)

The electrical coil former or bobbin has a centre winding section Ä12Ü and flanges at each end Ä16.18Ü The former is designed to receive a two part core. The ends of the former have formed connection strips Ä20,22Ü and these have a number of sockets Ä30Ü into which are set pins Ä28Ü. The ends of the coil wires are wrapped around the pins. The pins are located in stable positions and can be inserted into holes on a printed circuit board.

Abstract (de)

Beschrieben wird ein Spulenkörper mit einer durchgehenden Ausnehmung (14) für die Aufnahme eines zweischaligen Kerns (16), mit einem Wickelkörper (14), an dessen beiden Enden Flansche (16, 18) ausgebildet sind. An mindestens einem Flansch (16) ist eine in Querrichtung zur Längsachse der Ausnehmung (14) sich erstreckende Anschlußleiste (20, 22) ausgebildet, die mindestens drei nebeneinander angeordnete Lötanschlüsse (28) für um den Wickelkörper (12) gewickelte Wickeldrähte (50) hat. Die Lötanschlüsse sind als im wesentlichen zylindrische Stifte (28) ausgebildet, die in einer Ebene quer zur Längsachse vertikal absteht in voneinander beabstandeten Sockeln (30) eingebettet sind. Jeder Sockel (30) ist auf der dem zugeordneten Stift (28) zugewandten Seite abgerundet und trägt eine Umlenkvorrichtung (32), um die der Wickeldraht (50) vor dem Umwickeln des Stiftes (28) umgelenkt ist. <IMAGE>

IPC 1-7  
**H01F 5/04; H01F 41/10**

IPC 8 full level  
**H01F 5/04** (2006.01); **H01F 41/10** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**H01F 5/04** (2013.01 - EP US); **H01F 41/10** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [YA] WO 9300691 A1 19930107 - MOTOROLA LIGHTING INC [US]
- [YA] DE 2944583 A1 19800522 - TDK ELECTRONICS CO LTD
- [A] EP 0415643 A2 19910306 - AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]
- [A] FR 2493027 A1 19820430 - WEINER NORBERT [DE]
- [A] DE 3433700 A1 19860320 - SIEMENS AG [DE]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 005, no. 044 (E - 050) 24 March 1981 (1981-03-24)

Cited by  
EP2980814A4; DE202008012479U1; WO9931680A1

Designated contracting state (EPC)  
BE DE FI FR GB IT LU NL

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0773564 A1 19970514; EP 0773564 B1 19990414**; DE 19541447 A1 19970515; DE 59601652 D1 19990520; US 6559749 B1 20030506

DOCDB simple family (application)  
**EP 96117287 A 19961028**; DE 19541447 A 19951107; DE 59601652 T 19961028; US 72651596 A 19961007